

マイクロ加圧フリップチップボンダー Model:M@P-1000

マップ サウザンド

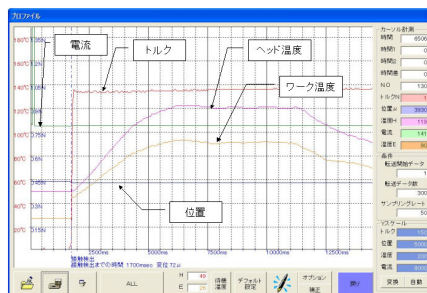
■ 主な特長

1. Frail 部品実装へのアルティメット・ソリューション ～ Frail(脆弱)部品実装を1台に集約 ～

- ◇ マイクロ加圧ユニットによる超低压熱圧着 : MIN 0.01N (約 1g 加圧)
- ◇ 低トルク定ギャップ制御
- ◇ フルクローズド制御による高精度実装 : $\pm 3 \mu\text{m}$ (3σ)
- ◇ 接触検知によるストレスレスチップ移載
- ◇ 多段階温度制御

2. 豊富なモニタリング機能

- ◇ ひとめ DE モニタリング
- ◇ ワンディスプレイ操作
- ◇ スピードレシピ登録
- ◇ 豊富なマーク認識機能



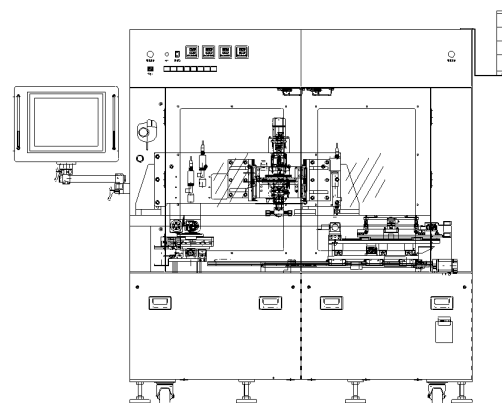
3. 対応商品

- ◇ SiP～PoP、CoC等、多様な実装に対応

■ 基本仕様

搭載荷重	0.01N ～ 0.2N $\pm 10\%$
実装後精度 *	$3\sigma \pm 3 \mu\text{m}$
基板寸法 (CoO)	min□ 50 mm ～ max□ 140 mm t 0.3～1.0 mm
チップ寸法 (CoC、CoO)	min□ 0.3 mm ～ max□ 15 mm
供給方式	トレイ/ウエハ
サイクルタイム *	16.0 秒/チップ
電源	3 相 AC200V $\pm 10\%$ 50/60Hz, 10KVA
圧空源	Dry air 0.49Mpa 以上
真空源	別置き真空ポンプ付属
装置寸法	Approx: 1650W×1000D×1800H
装置重量	Approx: 1,400kg

* 当社基準のプロセス条件の場合



[お問い合わせ先]

OEC 大崎エンジニアリング株式会社

営業本部

住所 埼玉県入間市狭山ヶ原 326 番地

TEL 04-2934-3491

<http://www.oec-inc.co.jp>